

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</div>
参与单位名称及人员姓名	长江证券、兴全基金、长信基金、西南证券、Point 72、Millennium、东北证券、相聚资本、民生加银、国泰海通证券、UBS、Balyasny、泰康基金、新华基金、新华资产、禾永投资、中信建投证券、朴拙资本、南象资管、大家保险、Redgate AM、Toroa AM、中投投资、毅恒资本、中信证券、正圆投资、英大基金、宏利基金、青骊投资、AIA、BNI、工银瑞信、银华基金、华夏久盈、国寿安保、乐瑞资产、冯源资本、Keystone Ivt、南洋银行、长盛基金、高信百诺、丝路基金、华安基金、鹏华基金、富兰克林华美投信、Schroders、Fountain Cap、摩根士丹利基金、金信基金、前海联合基金、长城基金、安信基金、JP Morgan、光大证券、兴银理财、博时基金、弘毅远方、江信基金、汇添富基金、天弘基金、嘉实基金、安联资管、华夏基金、英大资管、中科沃土基金、中邮基金
时间	2025 年 11 月
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 梁映珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流的问题：</p> <p>问题一：请问公司在 AI 眼镜的业务情况有什么变化吗？公司如何</p>

	<p><b>看待 AI 手机及 AI 端侧的发展趋势？</b></p> <p>答：在 AI 眼镜方面，公司为阿里近日发布的夸克 AI 眼镜赋能，提供超长续航电源芯片解决方案，其中,公司推出的国内首颗电池均衡限流 IC,有效解决了夸克 AI 眼镜双电池的均衡难题,确保两颗电池同步充放电,为 AI 眼镜的 24 小时长续航提供了稳定的电量基础，保障电池健康与系统安全。目前，公司在 AI 眼镜领域的产品已为多家知名品牌客户供货。</p> <p>近年来，AI 技术的发展重心正从算力基础设施向终端侧传导，而 AI 眼镜作为集视觉、听觉、语音等人体重要感知交互于一体的端侧硬件,已成为 AI 技术落地应用的载体之一，行业前景广阔。AI 手机的发展前景，已成为行业共识，各大知名品牌手机客户均从 AI 模型端及手机硬件匹配的设计思路出发,推动手机行业的 AI 创新。公司推出的多款电源领域的芯片产品服务于多家行业最头部的手机品牌厂商，并在多个领域保持优势的市场竞争地位，高转换效率的电源芯片方案能力不断创新迭代，助力品牌客户发展 AI 手机。</p> <p><b>问题二：公司今年后续及明年的业务情况如何？</b></p> <p>答：公司已发布第三季度报告，第三季度营收达 9.10 亿元，同比增长 40.26%，单季收入续创历史新高，继续保持季度同比成长趋势。</p> <p>下半年是消费电子传统旺季，公司在消费电子业务领域的占比仍然较大，随着各消费电子头部客户的新品发布，公司下半年整体有望进一步成长。此外，在汽车、工业、AI 等领域，随着公司新品推出及新客户的有效拓展，这些领域的业务规模及业务占比呈现快速成长趋势。公司对今年后续及明年的业务成长具备信心。</p> <p><b>问题三：公司如何展望后续的研发费用变化？</b></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>答：公司前三季度研发费用约 4.59 亿元，研发费用率为 19.28%，较去年同期提升近 4 个百分点，较去年全年水平也明显提高，第三季度单季研发费用 1.76 亿元，随公司季度营收、毛利润有序提高。</p> <p>公司近年来业务规模持续扩大，新领域业务布局日渐丰富，公司会继续保持高质量的研发投入，巩固公司在消费电子竞争地位的同时，拓宽各核心大客户的业务空间，丰富在汽车、AI、工业、机器人等具体领域的业务机会，继续发挥公司在芯片设计、工艺平台的优势，保持进步，以产品能力、客户服务赢得竞争，持续提升公司的业务规模。</p> <p><b>问题四：公司当前毛利率变化的主要原因是什么？如何展望后续毛利率？</b></p> <p>答：毛利率受到产品价格、生产成本、业务订单景气度、公司自身业务结构等因素影响。公司第二季度毛利率阶段性承压，其中自身业务结构影响为主要因素，公司在智慧能源业务板块规模快速成长，占比在第二季度进一步提升，因该业务领域的行业毛利率相对较低，从而影响了公司整体毛利率。由于下半年业务规模继续扩大，产品结构略有优化，第三季度毛利率环比回升至 36.99%。毛利润随公司业务规模扩大，继续攀升，前三季度实现毛利润 8.80 亿元，第三季度实现毛利润 3.37 亿元，均较去年同期向上攀升。</p> <p><b>问题五：公司在 AI 算力电源方面的进展如何？</b></p> <p>答：公司今年三季度已正式为客户推出应用于 AI PC、边缘计算、工业电脑等领域的多相控制器。公司非常重视在 AI 服务器电源领域的业务机会，正积极布局 AI 算力电源生态，重点聚焦大电流领域，包括多相控制器、DrMOS、大电流 DCDC 等，同时还持续加快中高压侧电源领域相关电源、驱动等芯片的研发布局，目前已正式推出 700V 高压 GaN 半桥功率芯片、大功率 LLC SR 控制器</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>等产品。</p> <p><b>问题六：公司拟发行可转债，用于哪些方面？</b></p> <p>答：公司拟发行的可转债项目中，预计募集资金不超过 19.33 亿元，也将全部投入研发项目，包括智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目，助力未来成长。</p> <p>具体来看，算力电源项目，将聚焦解决大电流场景下多相架构电流均衡、精确移相等核心技术难题，重点开发多相控制器、DrMOS、大电流 DC-DC、大电流 PMIC 等一系列高性能电源管理产品；在工业传感器项目，将聚焦三大技术路线：光学传感器、惯性传感器、磁传感器，并同步开发高速高精度数字控制器，自研工艺平台，研发出能够应对复杂工业环境中微弱信号检测、多重干扰抑制等挑战的高精度、低功耗解决方案；在车载芯片项目，公司围绕车身、座舱、智驾三大核心领域，全面布局传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片和电源管理芯片等核心赛道，助力公司搭建“从供电、充电管理到传输、感知、决策、执行”的完整车载芯片生态系统。</p> <p><b>问题七：公司后续产能是否能够满足订单需求？</b></p> <p>答：公司在产能锁定、投片等环节均有制定计划，并会根据市场大环境的变化及时做出调整。目前，公司在汽车、消费、工业等多个领域业务需求饱满，通过与晶圆代工厂、封测厂商的有效战略合作，公司在产能分配上能够合理满足后续可见业务订单的需求。</p>
件清单 (如有)	无
日期	2025.11